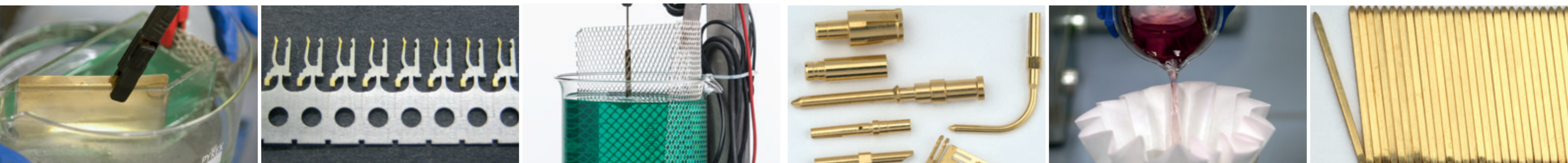


贵金属 电镀液



METALOR[®]



进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	电 流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	----------	-----------	-------	-------------------------	--------------	-----	-----	------	----	----	----

含氰镀金工艺

MetGold 2010 VBS Series	10088/10095	1.5 - 4.0	30 - 40	0.05 - 0.2	140 - 180	4.1 - 4.5		●		连接器	酸性，钴/镍基硬化，厚度分布改善
MetGold 2010 B Series	10087/10094	2 - 3	30 - 40	0.1 - 1.0	140 - 180	4.1 - 4.5		●		连接器	酸性，钴/镍基硬化，厚度分布改善
MetGold 2010 VR Series	10085/10092	3.5 - 6.0	30 - 40	0.5 - 2.0	140 - 180	4.2 - 4.9		●		连接器、PCB (印刷电路板)、部件	酸性，钴/镍基硬化，厚度分布改善
MetGold 2010 HS Series	10086/11171	6 - 10	30 - 60	1 - 60	140 - 180	4.2 - 4.9		●		连接器、PCB (印刷电路板)	酸性，钴/镍基硬化，厚度分布改善，高速，卷到卷工艺
MetGold 2010C (HS) RPC	10943	6 - 18	30 - 60	1 - 60	140 - 180	4.2 - 4.9		●		连接器	酸性，钴基硬化，孔隙减少，高速，卷到卷工艺
MetGold 3010C (HS)	11023	4 - 25	50 - 60	1 - 60	130 - 180	4.0 - 4.5		●		连接器	酸性，钴基硬化，浸渍最小化，高速
MetGold 3010N (HS)	11090	8 - 25	50 - 60	1 - 60	130 - 180	4.0 - 4.5		●		连接器	酸性，镍基硬化，浸渍最小化，高速
MetGold FB7000	12002	3 - 10	45 - 60	10 - 50	130 - 180	4.0 - 4.4		●		连接器	钴基硬化，高速局部电镀，卷到卷工艺
MetGold FB7000NI	12012	3 - 10	45 - 60	10 - 50	130 - 180	4.0 - 4.4		●		连接器	镍基硬化，高速局部电镀，高速，卷到卷工艺
MetGold HEB Series	10060	3 - 6	27 - 45	0.1 - 1.6	120 - 180	4.0 - 4.5		●		电子、电气部件	酸性，钴/镍基硬化，极高阴极效率，金含量低，完全可分析
MetGold HES Series	10061/10065	6 - 16	35 - 60	0.5 - 100	120 - 180	4.2 - 4.8		●		电子、电气部件	酸性，钴/镍基硬化，极高阴极效率，金含量低，完全可分析，卷到卷工艺
MetGold HS Series	10062/10068	2 - 16	35 - 60	5.0 - 50.0	120 - 180	4.0 - 5.0		●		PCB (印刷电路板)、连接器、电气部件	酸性，钴/镍基硬化，极高阴极效率，金含量低，完全可分析，卷到卷工艺
MetGold K130AF	12017	1	50	2	-	5.5		●		PCB (印刷电路板)、FPC	冲击镀，防霉特性



进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	电 流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	-------------	--------------	----------	----------------------------	-----------------	-----	-----	------	----	----	----

有氰镀金工艺

MetGold K160D	12018	1	55	2	-	5.5		●		PCB (印刷电路板)、FPC	铜基底冲击镀
MetGold K185ST	10123	5 - 20	55	0.8 - 60.0	130 - 160	4.4		●		开关、连接器等	钴基硬化，高速，卷到卷工艺
MetGold K186	10128	2 - 10	40 - 60	0.8 - 10.0	130 - 160	4.4 - 4.8		●		PCB (印刷电路板)、FPC	钴基硬化
MetGold K44	10126	8 - 10	65	1.0	80 - 120	6.3		●		PCB (印刷电路板)、FPC	酸性系统，用于无光泽纯金镀层
MetGold K440	10127	8 - 10	75	16	80 - 120	6.7		●		集成电路、导线架等	酸性系统，用于无光泽纯金镀层，高速，喷镀，卷到卷工艺
MetGold K700	10124	6 - 10	60 - 75	0.2 - 0.8	80 - 120	5.5 - 6.9		●		PCB (印刷电路板)、FPC	酸性系统（电沉积均匀），用于无光泽，均匀镀层
MetGold K720D	12019	5	65	0.5	80 - 120	6.3		●		PCB (印刷电路板)、FPC	酸性系统，用于铜基材上进行亚光，纯金电镀
MetGold K76	12020	3	35	0.3	130 - 160	3.8 - 4.0		●		开关、连接器	钴基硬化
MetGold Pure 99	10071	2 - 12	55 - 80	0.05 - 1.2	≤80	5.0 - 6.5		●		半导体、PWB	有光泽至半光亮极纯金镀层
MetGold Pure 99-4R	10074	2 - 8	40 - 60	0.05 - 0.4	≤80	6.0 - 7.0		●		半导体、PWB	有光泽至半光亮极纯金镀层，耐金属杂质
MetGold Pure 99-54	12003	2 - 24	50 - 60	0.05 - 0.4	≤80	5.5 - 7.0		●		半导体、PWB	有光泽至半光亮极纯金镀层，非常适合水性干膜光刻胶应用
MetGold Pure ATF	12004	5 - 15	55 - 70	0.5 - 20.0	90	5.5 - 7.0		●		微电子学应用	无砷，无铊，高速
MetClad 2000 Series	10007	1 - 6	25 - 40	0.8 - 1.0	160 - 220	3.5 - 4.2	●			皮革配件、奢侈品服饰珠宝	23 - 24 K 金镀层，颜色范围广，混色搭配
MetClad CdF 18KR	10703	3 - 5	50 - 70	0.5 - 1.8	250 - 350	9.5 - 10.6	●			优质服饰珠宝、表盒	亮铜光亮，耐腐蚀



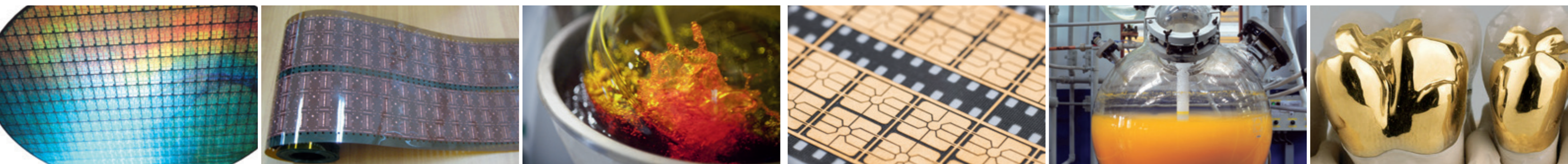
进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	电 流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	-------------	--------------	----------	----------------------------	-----------------	-----	-----	------	----	----	----

含氰镀金工艺

MetClad CdF 18KY	12005	4.5 - 5.5	65 - 70	0.6 - 0.8	400	9.8 - 10.2	●			表盒	无镍
MetClad NiF 2N	12006	3.5 - 4.5	35 - 40	0.5 - 1.0	220 - 280	3.4 - 4.0	●			一般装饰面	无镍
MetForm 18P	11108	5 - 7	65 - 72	0.5 - 1.5	200 - 400	9.8 - 10.8	●			电铸, 传统电镀	碱性系统, 用于金、铜、镉合金
MetGild 2000 Series	11106	0.5 - 1.0	50 - 60	4 - 6 V	-	10.0 - 11.0	●			镀金层和闪镀层	无镍, 锌, 铜, 亮银, 瑞士标准色, 混色搭配
MetGold MPColor Series	10056	0.5 - 1.0	55 - 65	6 - 12 V	-	9.0 - 11.0	●			镀金层和闪镀层	镍, 铜, 亮银, 瑞士标准色, 1N14 - 5N
MetGold MP109	10078	3 - 16	25 - 45	0.1 - 1.2	150 - 180	4.5 - 5.0	●	●		接触面、装饰面、PCB (印刷电路板)	亮钻光亮

化学镀金工艺

Atomex	12016	0.5 - 7.5	70 - 100	n.a.	-	5.0 - 8.0	●	●		装饰面、电子零件	氰化基浸镀工艺, 用于镍和铜基层电镀, 可焊性保护
Imex 510D	12021	3	80	n.a.	-	6.0		●		电子零件	氰化基浸镀工艺, 用于铜基层电镀, 可焊性保护
Ormex Series	10138/11109	1.0 - 6.8	90 - 95	n.a.	-	5.0 - 5.2			●	SMD (表面贴装设备)、微电子电路	氰化基浸镀工艺, 用于镍基层电镀薄金镀层, 可焊性保护
Supermex 250	10144	1 - 3	55 - 75	n.a.	-	6.5 - 7.5		●		半导体晶圆、连接器、电子部件	无氰化物浸镀工艺, 用于镍和钯基层电镀
Supermex 880	12022	1.75 - 2.25	55 - 65	n.a.	-	7.3		●		半导体晶圆、连接器、电子部件	无氰化物厚化学镀工艺, 用于金基层电镀



进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	电 流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	-------------	--------------	----------	----------------------------	-----------------	-----	-----	------	----	----	----

无氰镀金工艺

MetGold ECF11	12008	13 - 17	57 - 63	0.2 - 1.2	40 - 130 40 - 70*	7.4 - 7.8		●		硅片金凸点	亚硫酸钠基，退火后硬度低
MetGold ECF33B	10340	10 - 15	52 - 56	0.2 - 1.0	40 - 110 40 - 70*	7.6 - 8.0		●		硅片金凸点和线条印刷	亚硫酸钠基，退火后硬度低
MetGold ECF66A	10159	10	45	0.5	100 - 140	7.2		●		硅片精细线条印刷	亚硫酸钠基，亮金镀层
MetGold ECF7000	12014	13 - 17	55 - 59	0.4 - 1.0	40 - 130 60 - 80*	7.8 - 8.2		●		硅片金凸点	亚硫酸钠基，退火后硬度低/中
MetGold ECF78N	12023	10	50	0.3	80 - 120	9.5		●		硅片精细线条印刷	亚硫酸钠基，亮金镀层
MetGold ECF88K	10162	8 - 12	55 - 65	0.1 - 1.0	40 - 110 40 - 70*	7.6 - 8.0		●		硅片金凸点和线条印刷	亚硫酸钠基
MetGold ECF9000	12024	15	57	0.4 - 1.0	80 - 110 80 - 110*	8.0		●		硅片金凸点	亚硫酸钠基，退火后硬度高
MetGold NCF500	10158	1	25	0.8	-	8.4		●		硅片金凸点和线条印刷	亚硫酸钠基，用于镍基层层冲击镀金
MetGold NCF500D	12025	1	30	0.5 - 1.0	-	8.0		●		硅片金凸点和线条印刷	亚硫酸钠基，用于铜基层层冲击镀金
MetGold ECF64D	10149	12 - 18	50	0.3	120 - 180	9.1			●	牙科、工业应用	亚硫酸铵基

* 退火后

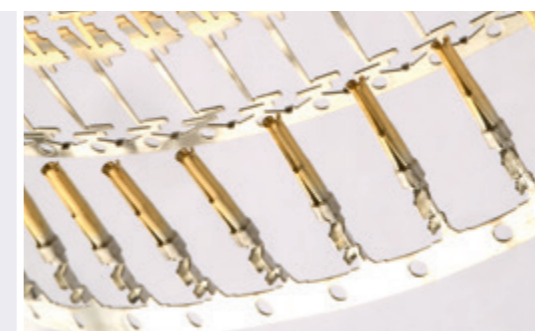




进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	电 流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	-------------	--------------	----------	----------------------------	-----------------	-----	-----	------	----	----	----

银电镀工艺

MetSil 150	10197	20 - 50	15 - 25	0.1 - 3.0	100 - 120	>12	●	●		一般装饰面、餐具、连接器、电子部件、微波盒	氰化基，用于无雾镜面光亮镀层
MetSil AG10	10203	60	20 - 25	20	100 - 120	13		●		连接器、开关	氰化基，碱性，光亮硬质镀层
MetSil AG20/AG30	12026/12027	80	40	7.0	80 - 120	13		●		电子部件	氰化基，碱性，光亮镀层
MetSil CNF Series	11051/11137	20 - 34	17 - 40	0.1 - 1.2	100 - 120	9.8 - 10.2	●	●	●	一般应用、光伏电池	无氰化物
MetSil Deco	10198	36	19-35	<2.5	120	-	●	●		装饰面、电子产品	氰化基，非金属般光亮
MetSil HCD	10212	50 - 80	60 - 70	45 - 220	100 - 120	8.0 - 10.0		●		半导体、导线架点镀	氰化基，弱碱性，高速
MetSil K900/S900	10218/10346	40 - 80	40 - 80	20 - 110	-	8.0 - 9.0		●		集成电路、导线架等	低氰，碱性，无光泽镀层，高速，卷到卷工艺，局部电镀
MetSil K930/S930	10219/12045	40 - 80	40 - 80	40 - 150	-	8.0 - 9.5		●		集成电路、导线架等	低氰，碱性，半光亮镀层，高速，卷到卷工艺，局部电镀
MetSil LED Bright AG20	12029	45 - 80	25 - 40	1.0 - 12.0	80 - 120	13		●		LED 电子部件	氰化基，碱性，光亮镀层
MetSil LED Silver 4000	12030	40 - 80	40 - 65	30 - 150	-	8.5		●		LED 基板	低氰，弱碱性，光亮镀层
MetSil LED Silver 4100	12031	40 - 80	25 - 30	2 - 4	-	8.5 - 9.5		●		LED 基板	低氰，弱碱性，低电流密度下的光亮镀层
MetSil N-Brite	10205	37.0	23	0.7 - 1.0	145 - 165	12.4	●	●		装饰面、电子产品	氰化基，碱性，光亮硬质镀层
MetSil S940	10208	40 - 100	40 - 80	100 - 200	80 - 100	8.0 - 9.5		●		集成电路、导线架等	低氰，碱性，半光亮镀层，高速，卷到卷工艺，局部电镀
MetSil SP4000	10221	40 - 90	50 - 70	50 - 200	80 - 100	8.0 - 9.5		●		集成电路、导线架	低氰，碱性，半光亮镀层，高速，卷到卷工艺，局部电镀



进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	电 流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	-------------	--------------	----------	----------------------------	-----------------	-----	-----	------	----	----	----

钯电镀工艺

MetPal 2000B	10163	1.5 - 2.5	20 - 35	0.3 - 1.0	400	7.8 - 8.5	●	●		一般装饰面、服饰珠宝、电子	无镍，轻度碱性至中性，纯钯闪镀工艺
MetPal III Pure Pd Deco	10769	1 - 5	55 - 75	0.8 - 5.0	390 - 560	3.5 - 4.5	●			一般装饰面、珠宝	专利工艺，无氨，无氯化物，纯钯
MetPal III Pure Pd Strike	11115	1 - 4	55 - 75	1 - 15	390 - 560	3.5 - 4.5		●		连接器、半导体	专利工艺，无氨，无氯化物，纯钯，高速
MetPal Brite GB1	11113	2 - 12	30 - 65	0.25 - 1.50	400 - 550	7.0 - 8.0	●			一般装饰面	无镍，轻度碱性至中性，纯钯工艺，白色，光亮镀层
MetPal C	10176	8 - 12	32 - 40	0.5 - 2.7	290 - 480	6.8 - 7.5		●		连接器和半导体	氯化基，纯钯
MetPal EPD	10193	2 - 6	40 - 60	-	400 - 550	1.5 - 2.5		●		PCB (印刷电路板)、铜和焊盘的直接金属化	硫酸盐基，化学镀，纯钯
MetPal LF800S	12034	4 - 6	35 - 50	1.5	-	8.0 - 9.0		●		导线架	纯钯，薄镀，可焊性好，适合预镀框架，卷到卷工艺
MetPal S	10178	10 - 20	35 - 46	0.2 - 2.2	200 - 240	6.0 - 9.5		●		连接器、半导体、PCB (印刷电路板)	硫酸盐基，可延伸，纯钯
PallaMex 800	10862	1.5 - 2.5	50 - 75	-	-	5.5 - 6.5		●		PCB (印刷电路板)、半导体晶圆、正型光刻胶	化学镀，碱性，纯钯，半光亮镀层





进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	电 流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	-------------	--------------	----------	----------------------------	-----------------	-----	-----	------	----	----	----

钯合金电镀工艺

MetPal 820	10190	20	30	1	550	8.8	●	●		装饰面、工业品、电子产品	碱性，低氨，钯镍合金
MetPal 820HS	10192	20	35	50	550	8.0		●		电子产品、连接器	碱性，低氨，钯镍合金，高速，卷到卷工艺
MetPal I HS	10184	18 - 22	30 - 35	3 - 50	390 - 560	7.8 - 8.5		●		连接器、半导体	氯化基，钯镍，高速，喷镀，局部
MetPal I Pd-In D	12007	4 - 6	45 - 47	0.5 - 0.9	280	8.0 - 8.5	●	●		一般装饰面、电子产品	无镍，钯钢，喷镀，局部
MetPal II HS	11114	12 - 25	30 - 55	3 - 50	390 - 560	7.5 - 8.5		●		连接器、半导体	低氨，钯镍，高速，喷镀，局部
MetPal III Pd-Ni HS	10183	10 - 23	60 - 75	25 - 60	390 - 560	3.5 - 4.5		●		连接器、半导体	专利工艺，无氨，无氯化物，钯镍，低至高速，喷镀，局部
MetPal III Pd-Ni V&B	11126	3 - 5	55 - 75	1.5 - 2.5	390 - 560	3.5 - 4.5	●	●		装饰面、电子产品	专利工艺，无氨，无氯化物，钯镍

铂电镀工艺

Met-Pt 200S	11116	2 - 10	25 - 70	0.5 - 10.0	400	0.5 - 1.5	●	●		不同条件下的各种基底	光亮硬质镀层
Met-Pt 209	10258	4 - 6	80 - 90	2 - 8	400 - 500	8.0 - 9.0		●	●	航空涡轮叶片、钛阳极	无光泽、粘附性、低应力镀层

铜合金电镀工艺

MetWhite 100	11112	-	45 - 65	1 - 4	400 - 500	12 - 13	●	●		装饰面、电子部件	氰化基，白铜，代替镍作为阻挡层或最终接触表面处理
MetWhite 100 PbF	10705	-	55 - 70	0.5 - 3.0	-	13.4 - 14.0	●	●		装饰面、电子部件	氰化基，无铅，白铜，代替镍作为阻挡层或最终接触表面处理，符合 RoHS



进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	电 流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	-------------	--------------	----------	----------------------------	-----------------	-----	-----	------	----	----	----

铑电镀工艺

MetBrush Rh	10645	20	20 - 30	-	750 - 900	<1.0	●			珠宝	闪亮白色至灰色镀层，刷镀
Met-Rh 225 Series	10248	4 - 6	50 - 60	0.25 - 2.0	700 - 900	0.5 - 1.5		●		簧片开关、半导体晶圆、一般电子产品/工业品	硫酸盐基，硬质，可延伸，低应力，无光泽至半无光镀层，厚度达 12 微米
Met-Rh 4040 D	12044	1 - 4	30 - 50	0.2 - 3.0	910 - 1080	0.5 - 1.5	●			珠宝、表盒、表带、眼镜架	硫酸盐基，超白亮反光镀层
Met-Rh 4040 E	10250	4 - 6	20 - 60	0.3 - 2.0	780 - 1080	0.5 - 1.5		●		PCB、真空管栅极、半导体、簧片开关	硫酸盐基，压缩应力，无裂纹，可延伸，厚铑镀层
Met-Rh F100	11119	1.5 - 4.0	35 - 50	5 - 15	700 - 900	<1.0	●			装饰面	硫酸盐基，闪镀层
Met-Rh FW	12035	2	40 - 70	5 - 15	700 - 900	<1.0	●			装饰面	硫酸盐基，白色光亮镀层
Met-Rh S515W	12015	1.6 - 2.2	25 - 40	0.5 - 3.0	800 - 900	<1.0	●			珠宝、表盒、表带、眼镜架	超白亮闪镀层
Met-Rh W	10244	2 - 4	40	2	750 - 900	<1.0	●			装饰面	磷酸盐基，高等级闪镀层
Met-Rh Infinity	11121	0.5 - 4.0	18 - 60	0.5 - 10.0	800 - 900	<1.0	●			珠宝、定制珠宝、皮革配件、礼品、眼镜架	硫酸盐基，超白亮闪镀层和高厚度镀层

钉电镀工艺

Met-Ru 2000	11125	3 - 20	50 - 70	0.5 - 2.0	600 - 900	1.0 - 1.9	●			一般装饰面	硬质，光亮镜面类镀层，混色搭配，灰色到深灰色
Met-Ru 3000 Black	11019	5	60 - 70	2 - 5	-	0.1 - 0.5	●			一般装饰面	光亮特黑镀层



进程 工艺名称	产品介绍表 编号	贵金属含量 g/L	温度 °C	電 电流密度 A/dm ²	硬度 (Vickers)	酸鹼值	装饰性	电子产品	其他	用途	特性
---------	-------------	--------------	----------	-----------------------------	-----------------	-----	-----	------	----	----	----

处理

ChemiStrip NB Au stripper	12036	-	30 - 40	-	-	-	●	●	●	局部镀金	退金
ChemiStrip XO Cu stripper	10344	-	40	-	-	-	●	●	●	冲击镀	退铜，用于铁镍基底
Met-Cu Protect 100	12050	-	45 - 60	-	-	4.0 - 5.0	●	●	●	镀铜产品的无铬钝化	优质镀铜后处理，用于电镀防锈
MetTreat 100 Au stripper	10322	-	18 - 50	-	-	12.0	●	●	●	从铜、铜合金、镍和镍合金浸渍剥离	退金，碱性系统，对于基底金属影响极小
MetTreat 300 Rh stripper	11044	-	70 - 80	1.0 - 1.5/piece	-	-	●			从白金合金电解剥离	退铑，酸性系统，对于基底金属影响极小
MetTreat 1000 Au sealant	12051	-	50 - 55	-	-	8.0 - 9.0	●	●		在金镀层中进行适当的孔隙封闭，作为防腐辅助措施	额外性的黄金腐蚀保护
MetTreat SuperDip A	10348	0.1 - 2.5	25 - 40	-	-	-		●		镀银导线架	铜面防置换镀银，高速，卷到卷工艺
MetTreat PowerDip EW	10345	0.05 - 1.0	25 - 40	-	-	9.0 - 10.5		●		镀银导线架	铜面防置换镀银，卷到卷工艺
MetTreat SAG500	10342	-	20 - 60	0.2 - 25.0	-	9.2 - 10.5		●		从镀银导线架电解剥离	退银
MetSil Protect 200/300	11123/12052	-	40 - 60	-	-	4.0 - 10.0	●	●	●	镀银产品的无铬钝化	优质镀银后处理，用于电镀防锈
MetTreat LED Guard 88	12037	-	25	-	-	-		●		LED工艺的镀银后处理	镀银后处理，用于引线接合
MetTreat LED Guard H3	12038	-	40	-	-	-		●		LED工艺的镀银后处理	镀银后处理，用于电镀防锈
MetTreat LED Guard S1	12039	-	25	-	-	-		●		LED工艺的镀银后处理	镀银后处理，用于电镀防锈
MetTreat PET880	12040	-	25	-	-	-		●		LED工艺的镀铜后处理	镀铜后处理，用于电镀防锈

ADVANCED COATINGS BUSINESS GROUP

CHINA

Metalor Technologies (Suzhou) Ltd.
B building, 48 Dong Fu Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province
P.R. China 215123
Phone +86 512 6593 6181
Fax +86 512 6593 6171
advanced_coatings.cn@metalor.com

Dongguan Branch Office
Unit B213, Wanbao Cheng
Dezheng E. Road, Changan
Dongguan, Guangdong Province
P.R. China 523856
Phone +86 769 8544 3938
Fax +86 769 8544 3933

FRANCE

Metalor Technologies (France) S.A.S.
11, Rue Louis Aulagne
F-69600 Oullins
Phone +33 4 72 66 32 10
Fax +33 4 72 66 37 20
advanced_coatings.fr@metalor.com

HONG KONG

Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.
Suite 1705-9 The Metropolis Tower
10 Metropolis Drive
Hungghom, Kowloon
Hong Kong – China
Phone +852 2521 4131-5
Fax +852 2845 1791
advanced_coatings.hk@metalor.com

ITALY

Metalor Technologies (Italia) S.r.l.
Via Volturmo, 37
I-20861 Brugherio (MB)
Phone +39 039 214 20 85
Fax +39 039 88 41 62
advanced_coatings.it@metalor.com

JAPAN

Metalor Technologies (Japan) Corporation
9F, Shinagawa East One Tower
2-16-1, Kohnan, Minato-Ku
Tokyo 108-0075
Phone +81 3 6863 3385
Fax +81 3 6863 3565

Numazu Plant

678 Ipponmatsu, Numazu-City
Shizuoka-Prefecture 410-0314
Phone +81 55 967 9641
Fax +81 55 968 0986

Mitomo Semicon Engineering Co. Ltd.

Tsukuba Plant
25-3, Koshindiara, Bando-City
Ibaraki-Prefecture 306-0608
Phone +81 297 36 8800
Fax +81 297 36 8802

KOREA

Metalor Coatings (Korea) Corporation
5F Suwon venture Plaza
Samsung-ro 168-48 (Maetan-dong 413-3)
Yongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-803
Phone +82 2 3453 4264
Fax +82 2 3453 4147

NETHERLANDS

Metalor Technologies (UK) Ltd.
Netherlands Branch
Weegschaalstraat 3
NL-5632CW Eindhoven
Phone +31 40 291 1265
Fax +31 40 291 1266
advanced_coatings.nl@metalor.com

SINGAPORE

Metalor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.
Surface Engineering Hub
8 Buroh Street #01-06
Singapore 627563
Phone +65 6586 3333
Fax +65 6863 0102
advanced_coatings.sg@metalor.com

SPAIN

Metalor Technologies (Ibérica) S.A.
C/ Albasanz, 14 bis, 1ºG
E-28037 Madrid
Phone +34 91 375 7480
Fax +34 91 304 4142
advanced_coatings.es@metalor.com

SWEDEN

Metalor Technologies (Sweden) AB
Sagagatan 22
S-506 35 Boras
Phone +46 33 444 250
Fax +46 33 444 260
advanced_coatings.se@metalor.com

SWITZERLAND

Metalor Technologies SA
Route des Perveuils 8
CH-2074 Marin
Phone +41 32 720 6111
Fax +41 32 720 6612
advanced_coatings.ch@metalor.com

TAIWAN

**Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.
Taiwan Branch**
6F, 101 Rei-Hu Street
Nei-Hu
Taipei, Taiwan R.O.C.
Phone +886 2 7720 7775
Fax +886 2 7720 0303
advanced_coatings.tw@metalor.com

Metalor Coatings (Taiwan) Corporation

16 East 7th Street
Nan-Tze Export Processing Zone
Kaohsiung, Taiwan R.O.C.
Phone +886 7 368 0560
Fax +886 7 365 3174

THAILAND

**Metalor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.
Bangkok Representative Office**
335/43, 7th Floor, Prime State Office
Sirnakarin Road, Nongbom, Pravej District
TH-Bangkok 10250
Phone +66 2366 0719
Fax +66 2366 0720
advanced_coatings.th@metalor.com

UNITED KINGDOM

Metalor Technologies (UK) Ltd.
74, Warstone Lane
UK-Birmingham B18 6NG
Phone +44 121 262 3088
Fax +44 121 236 3568
advanced_coatings.uk@metalor.com

USA

Metalor Technologies USA Corporation
52 Gardner Street
USA-Attleboro, MA 02703
Phone +1 508 226 4470
Fax +1 508 695 4180
advanced_coatings.us@metalor.com

255 John Dietsch Boulevard
USA-North Attleboro, MA 02763
Phone +1 508 699 8800
Fax +1 508 695 4828

1640 Thomas Street
USA-Port Huron, MI 48061
Phone +1 508 699 8800
Fax +1 810 985 5132

免责声明

本数据清单提供了关于Metalor产品的性能、组成和使用的信息。该信息仅为方便客户而提供。本清单中任何数据或有关某种产品的选择和/或使用
的建议均不构成任何明示或默示的保证。所有关于适销性、特定用途之适用性或侵权的保证均明确予以免责。本数据清单或Metalor所提供的其
他信息中的任何内容均不应解释为建议或诱使以侵犯某项现有或未来专利的方式生产或使用任何工艺或产品。所有销售均应明确依据印在每张发票
背面的Metalor标准条款及条件进行。Metalor对于任何因未按照Metalor设计的方式、工艺或配方而加工或使用某种产品所导致的损失均不负责。



LPPM
Good Delivery
Referee



LBMA
Good Delivery
Referee



Metalor Technologies SA
Route des Perveuils 8, CH-2074 Marin
Tel. +41 (0) 32 720 6111, Fax +41 (0) 32 720 6112
advanced_coatings@metalor.com, www.metalor.com

METALOR®